

## 教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號

承辦人：翁如慧

電話：(02)7712-9111

電子信箱：juhuiw@mail.moe.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年9月2日

發文字號：臺教資(二)字第1142702699號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本部114年度「晶片前瞻技術模組教材推廣計畫徵件須知」，請查照。

說明：

- 一、依據本部補助推動人文及科技教育先導型計畫要點辦理。
- 二、本徵件須知旨為因應目前市場需求且國內半導體技術快速升級，配合目前新穎鰭式電晶體技術(如ADFP虛擬製程)，為鼓勵已完成簽屬TSMC University FinFET Program NDA協議之國內大學校院發展建置符合晶片前瞻技術所需教學資源及能量，同時搭配業界領先封裝技術課程，透過開授晶片前瞻技術相關課程，使各校學生能有機會學習到新穎鰭式電晶體技術之設計技巧及經驗，培育業界所需前瞻設計人才。
- 三、旨揭計畫採部分補助，相關自籌經費、經費編列、撥付及支用原則詳如所附徵件須知。
- 四、申請方式：免備文，請於114年9月30日前至線上申請表單(<https://reurl.cc/XQEGYe>)，完成線上申請及用印後計畫書電子檔上傳作業，逾期未完成線上申請及計畫書電子檔上傳者，不予受理。(洽詢電話：(03)571-2121 分機54426，先進製程IC設計人才培育計畫-子計畫1推動計畫辦公室林小姐)。
- 五、本徵件須知及相關附件(含計畫申請書格式)可於本部網站(首頁/認識教育部/本部各單位/資訊及科技教育司/電子布

告欄) 或本計畫網站<https://moeisoc.web2.ncku.edu.tw/> 下載。

六、徵件說明：本部訂於114年9月16日(二)14時，地點：國立陽明交通大學工程五館7樓725會議，報名表：<https://forms.gle/ZzpWRxNaKpJ7XuHa9>，請轉知相關系所教師參加。

正本：各公私立大學校院

副本：國立陽明交通大學電子研究所(先進製程IC設計人才培育計畫子1辦公室)、國立臺灣大學電子工程學研究所(先進製程IC設計人才培育計畫總辦公室)(均含附件)